

2021年3月期 第2四半期 決算説明資料

次なる成長に向けた事業戦略

2020年11月20日



内外テック株式会社
JASDAQ3374

● 2021年3月期 第2四半期 連結業績	2
● 業績実績	3-6
● セグメント情報	7-8
● トピックス	9
● 貸借対照表	10
● キャッシュフロー計算書	11
● 2021年3月期 連結業績予想	12
● 業績予想	13
● セグメント予想	14
● 次なる成長に向けた事業戦略	15
● 事業環境	16-18
● 新株予約権発行による資金調達の実施	19-21
● 本ファイナンスの目的	22-24
● (参考資料) 会社概要	25-27

2021年3月期 第2四半期 連結業績

代表取締役社長 岩井田 克郎

業績

- **第2四半期は、売上高・利益ともほぼ予想（7月10日公表）通り
前年同期比増収増益**
 - ⇒ ロジック・メモリー向け投資の増加による1Qの好調が牽引
2Qは半導体メーカーの工場立上げの遅れや顧客の在庫
調整等により一時的な減速
- **通期については、予想（7月10日公表）を変更せず**

トピックス

- **宮城県大衡村に2020年9月宮城物流センター新棟竣工・移転**
 - ⇒ 中長期的な半導体需要の拡大に向けた物流体制の強化

ほぼ予想通り、前年同期比増収増益

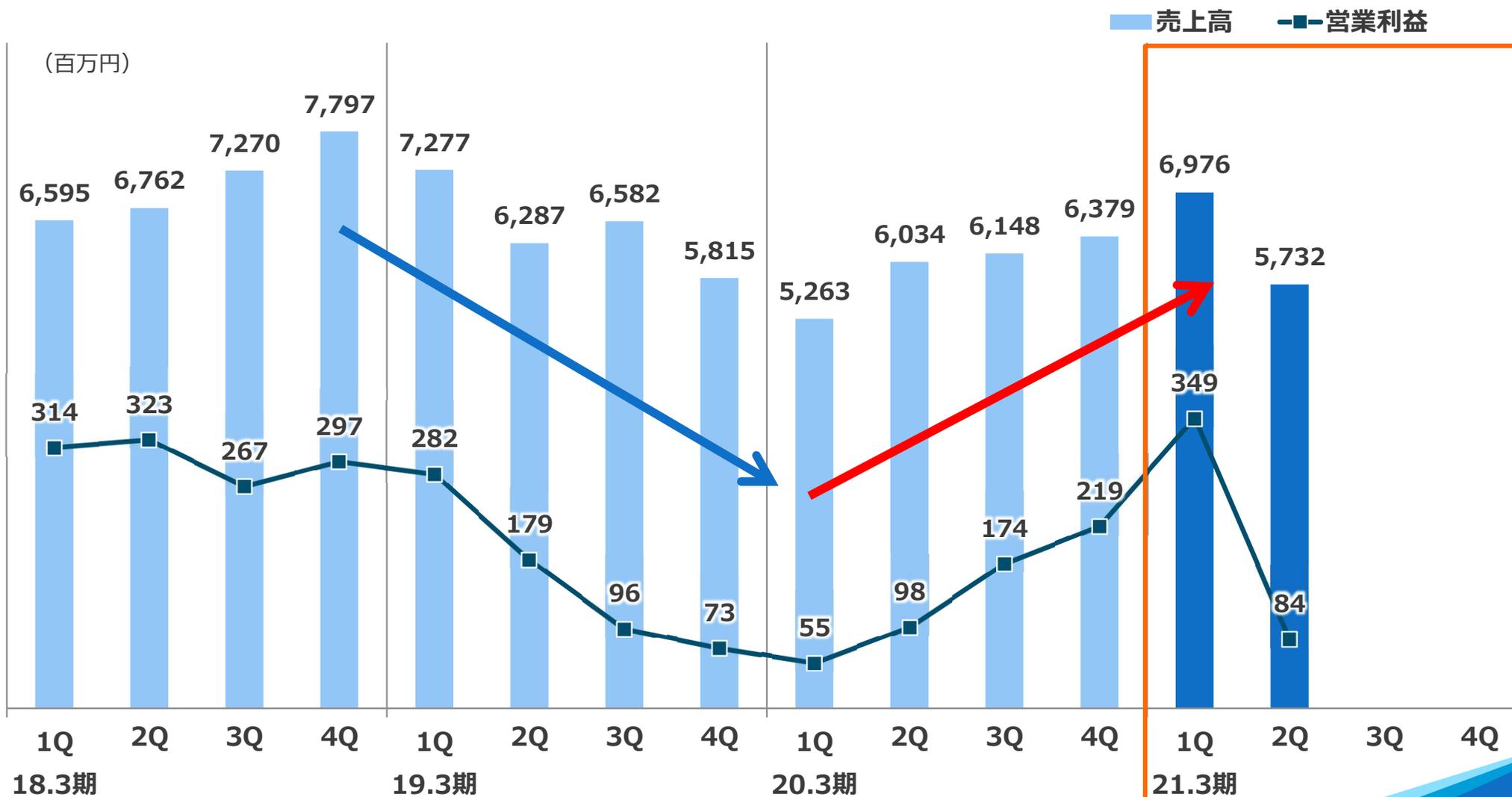
(百万円、%)

	2020.3期 上期			2021.3期 上期			予想 (7月10日公表)
	実績	前年同期比	構成比	実績	前年同期比	構成比	
売上高	11,297	△16.7	100.0	12,709	12.5	100.0	12,500
売上原価	10,107	△15.7	89.5	11,230	11.1	88.4	-
販管費	1,036	△7.2	9.2	1,045	0.9	8.2	-
営業利益	154	△66.6	1.4	434	2.8倍	3.4	415
経常利益	146	△67.9	1.3	425	2.9倍	3.4	410
親会社株主に帰属する 四半期純利益	77	△73.5	0.7	274	3.6倍	2.2	260

- 売上高は、テレワーク等によるデータ通信量増加等を背景に前期からの堅調なロジック向け投資の更なる増加に加え、メモリー向け投資の回復により増収。
- 販管費は、新型コロナウイルス感染症対策や物流センター移転に係る一時的な費用があるも、効率化の推進によりほぼ前年同期並みに。
- 各段階利益は、増収効果により増加。

1Qは好調も、2Qは売上高・営業利益ともに急減

- 2Qは、1Qの新型コロナウイルス感染症拡大に伴うテレワーク等の利用増加による半導体特需の反動や顧客の在庫調整等により売上・営業利益ともに減少

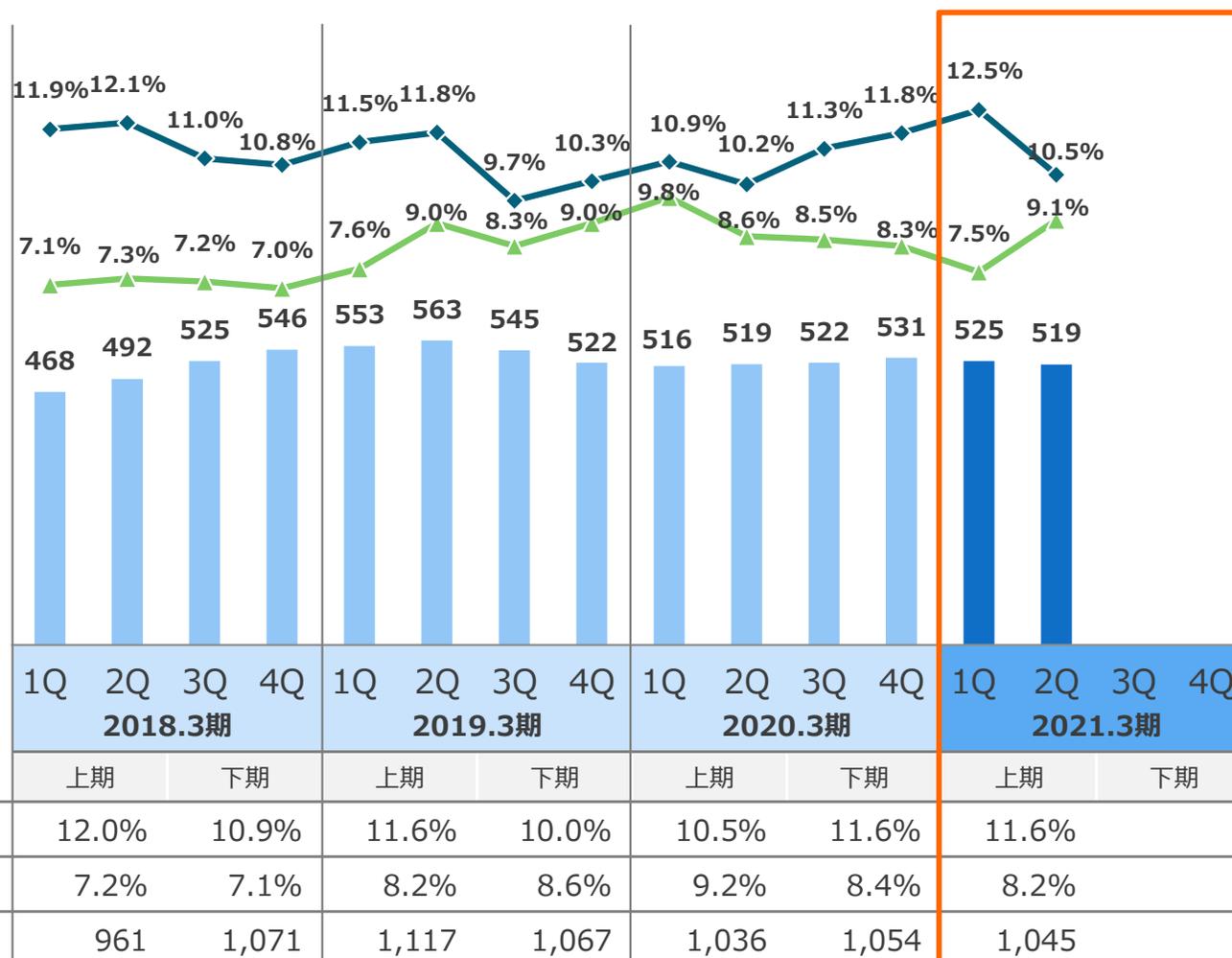


売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

売上総利益率は、1Qまで上昇傾向も2Q低下 販管費は、一定水準で推移

(百万円)

■ 販管費 ◆ 売上総利益率 ▲ 販管費率



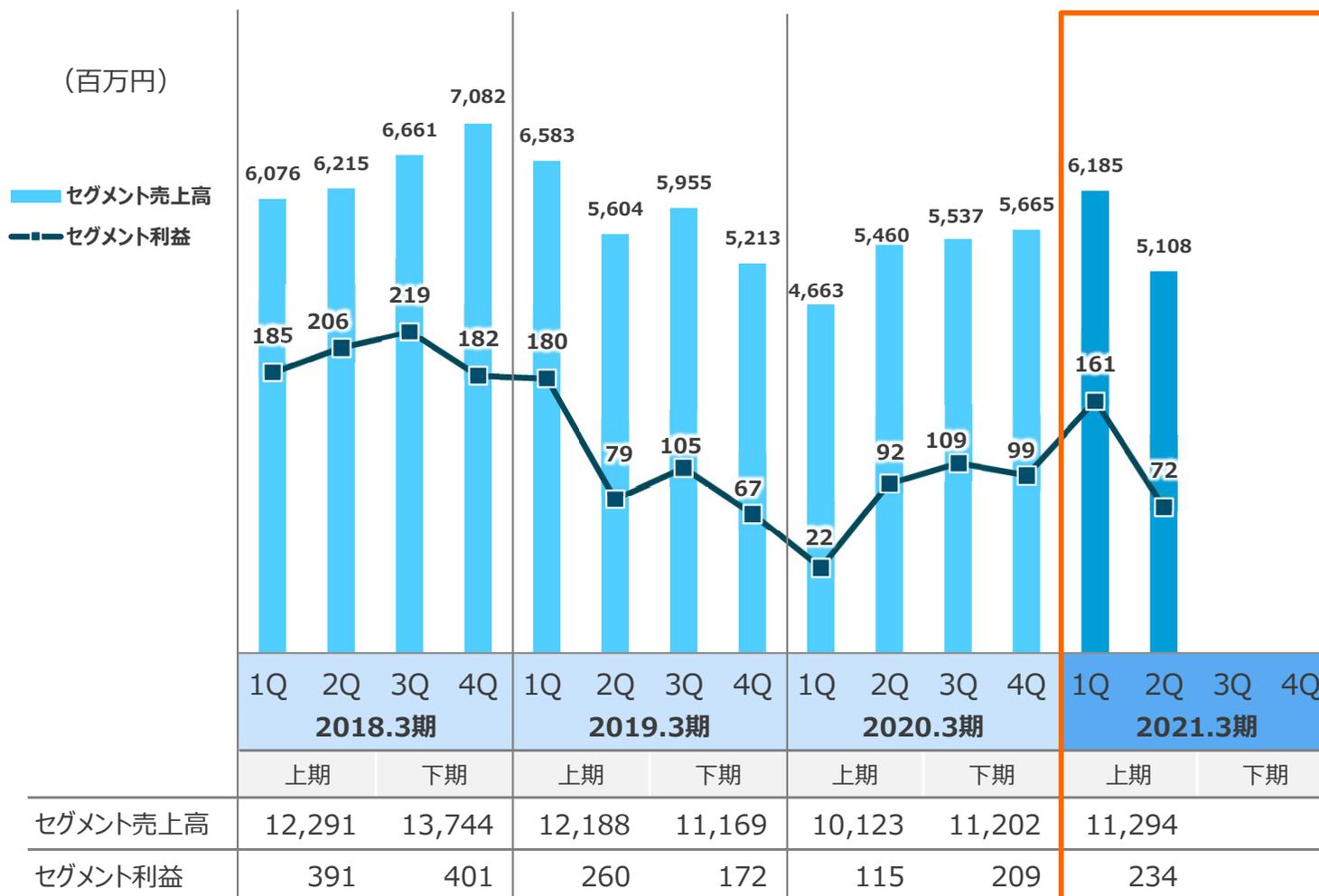
売上総利益率

- 増収効果による1Qの上昇で上期利益率は高水準維持。
- 2Qは、売上減少に加え、下期の回復に備え製造人員を維持したことによる低下。

販管費・販管費率

- 新型コロナウイルス感染症対策や物流センター移転等の一時的費用があるも、効率化の推進により販管費は一定水準で推移。
- 2Qは、減収により販管費率上昇。

1Qの売上増加を受け、上期利益は倍増



(注) 売上高は連結調整前

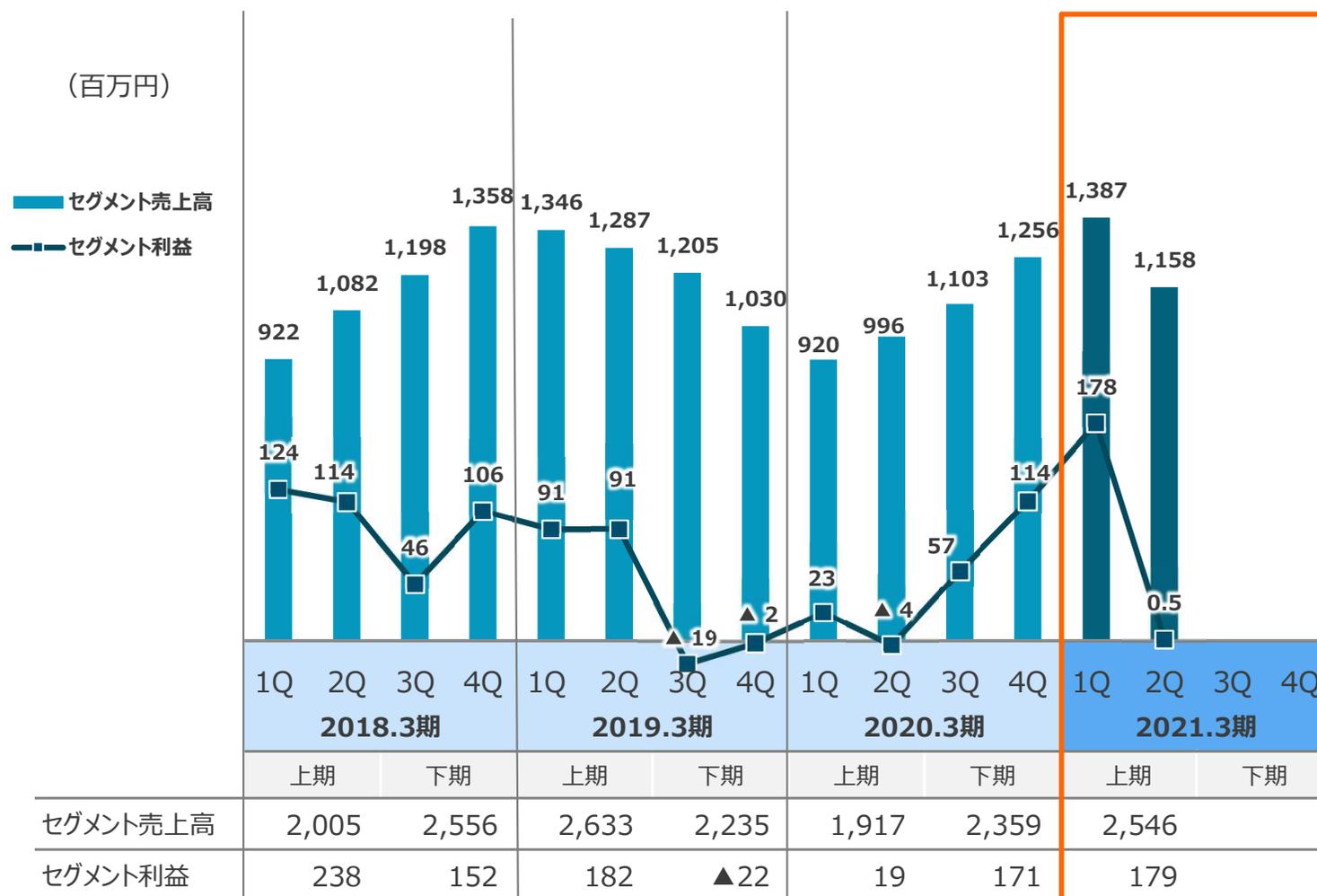
セグメント売上高 11,294百万円
(前年同期比 11.6% )

- 1Qはテレワーク等によるトラフィック量増加を背景にデータセンター投資の活発化を受けて、ロジック向け投資に加え、メモリー向け投資の回復基調が強まった。
- 2Qは新型コロナウイルス感染症の影響を受け工場立上げの遅れや米中摩擦等を背景に、半導体メーカーの投資の一時的な先送りなど調整局面。

セグメント利益 234百万円
(前年同期比 2.0倍 )

- 1Qの売上増加が寄与し、上期は大幅増益。

1Qは大幅増収増益も、2Qは投資一服で急減



(注) 売上高は連結調整前

セグメント売上高 2,546百万円
(前年同期比 32.8% )

- 半導体主要メーカーの投資拡大を受けて前4Qから急拡大した需要が1Qも続伸し、上期は大幅増収。
- 2Qは半導体メーカーの投資拡大一服等で減収。

セグメント利益 179百万円
(前年同期比 9.4倍 )

- 売上増加及び1Qの生産効率改善が貢献し、上期は大幅増益。
- 2Qは売上減少に加え、下期の回復に備え製造人員維持のため減少。

● 中長期的な半導体需要の拡大に備えた物流戦略の一環として、宮城県大衡村に2020年9月宮城物流センター新棟竣工・移転

従業員の安全への考慮やより良い職場環境を提供することによる作業効率の向上を目指した物流センター

① 倉庫面積の拡大

- ・ 1,465㎡から2,125㎡に拡張（約1.45倍）
- ・ 保管面積の拡張が可能な2段ラックの導入

② 保管面積の拡張による作業効率の向上

- ・ 通路幅を拡張し移動動線の短縮
- ・ 大量に商品の搬送が可能なカートの導入



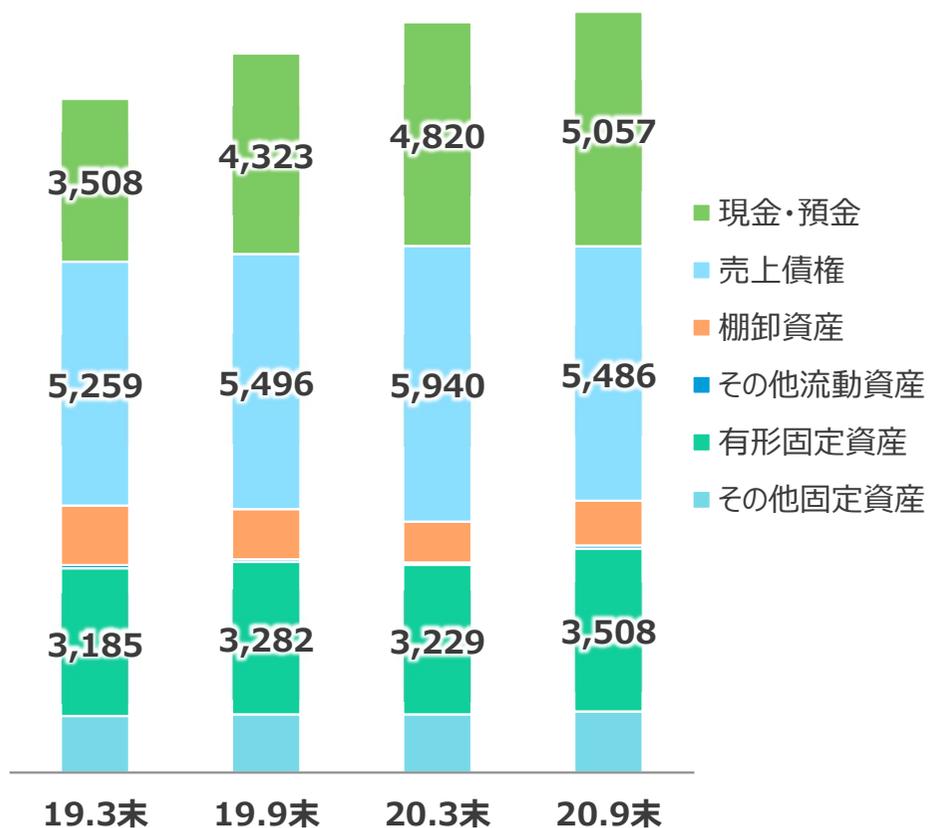
【参考：当社の物流拠点】

- ・ 宮城物流センター…海外を含む九州地区以外を担当
- ・ 九州物流センター…九州地区を担当

貸借対照表

◆ 資産

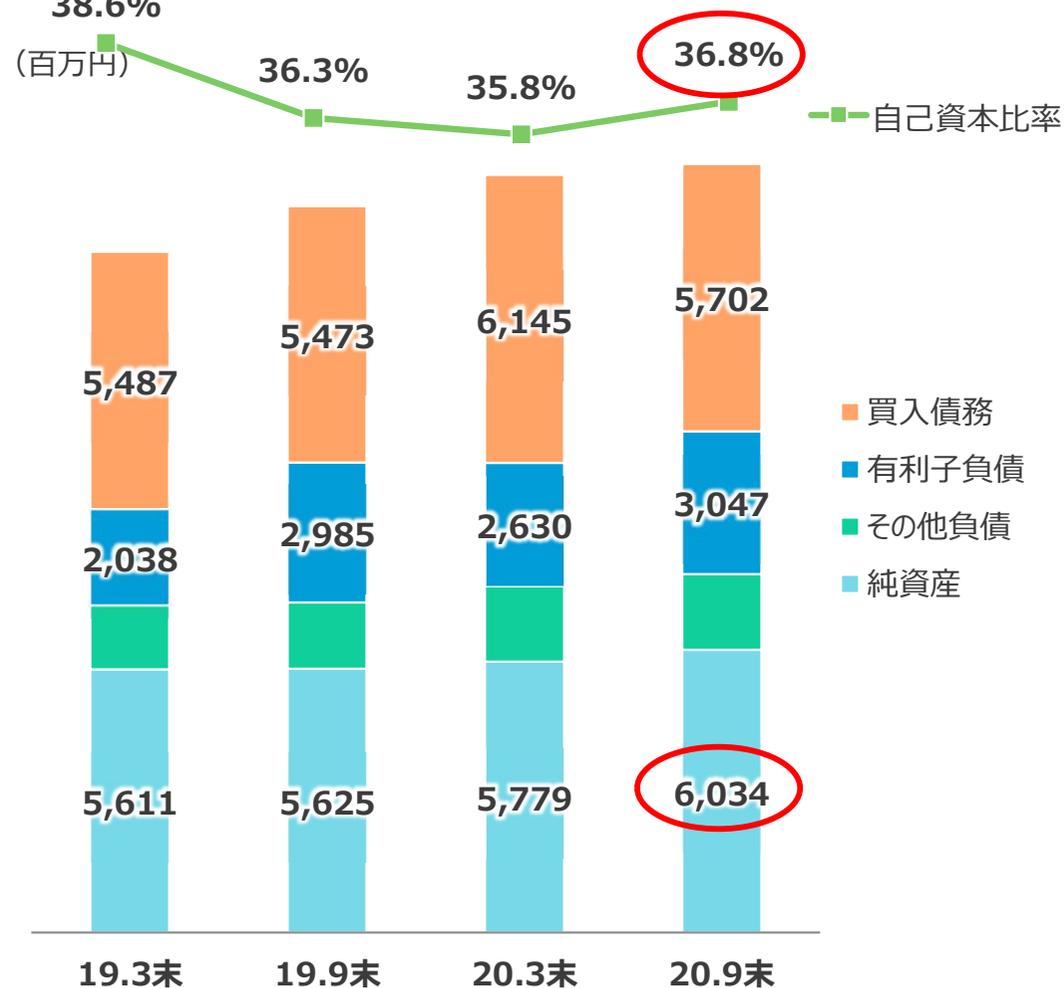
(百万円)



- 2Qの売上減少傾向により売上債権は4億53百万円減少。
- 宮城物流センター新棟完成により有形固定資産は2億79百万円増加。

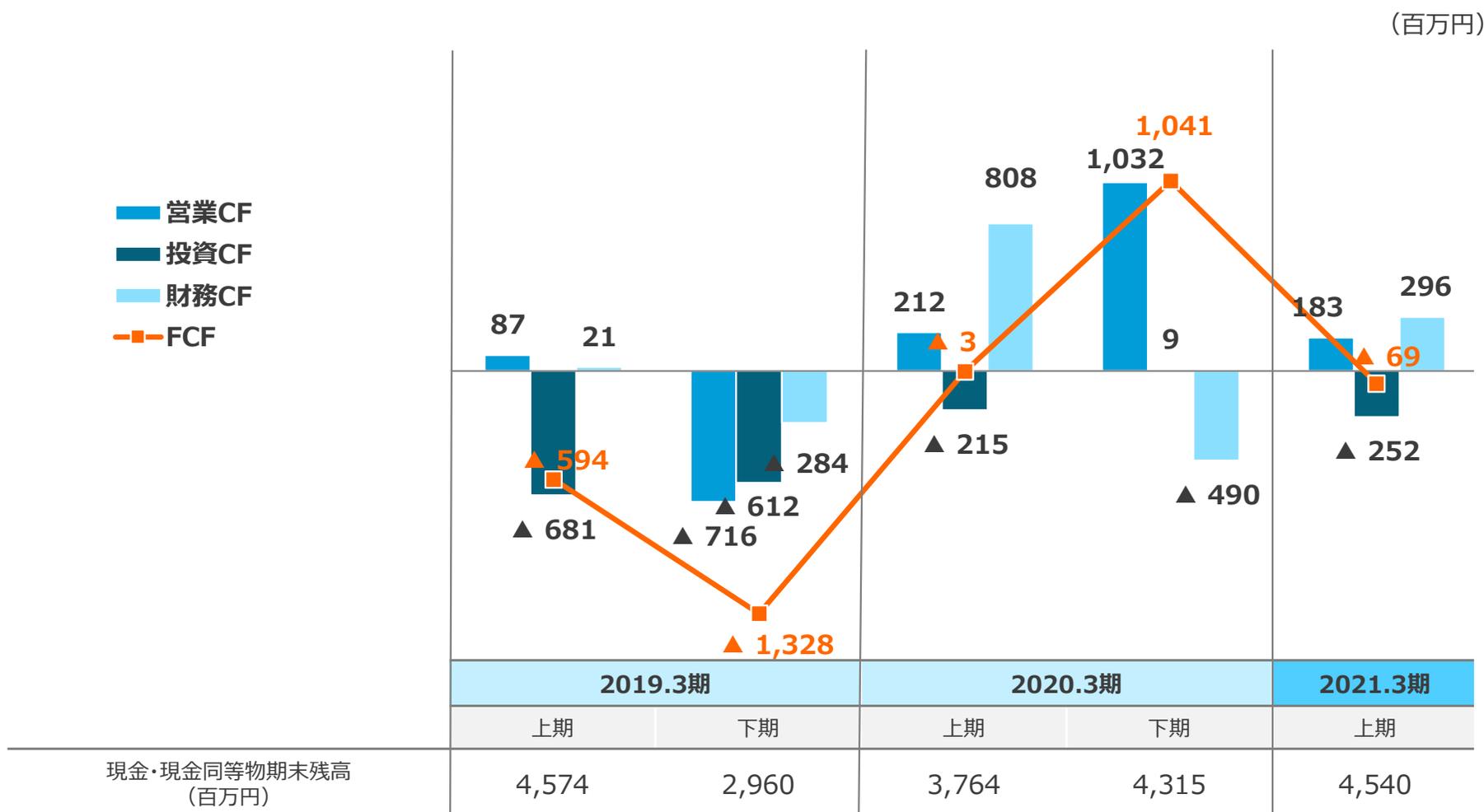
◆ 負債・純資産

(百万円)



- 利益の積み上げにより純資産は2億54百万円増加し、自己資本比率は36.8%に向上。
- 有利子負債は、期初の借入により4億16百万円増加。

業績好調に伴う借入抑制により財務キャッシュフローは減少 現金及び現金同等物残高は、45億円に



2021年3月期 連結業績予想

2021年3月期 業績予想（変更なし）

5G対応のスマートフォンや基地局向け半導体の需要は底堅いも、先行き不透明感が残り、予想（7月10日公表）を据え置き

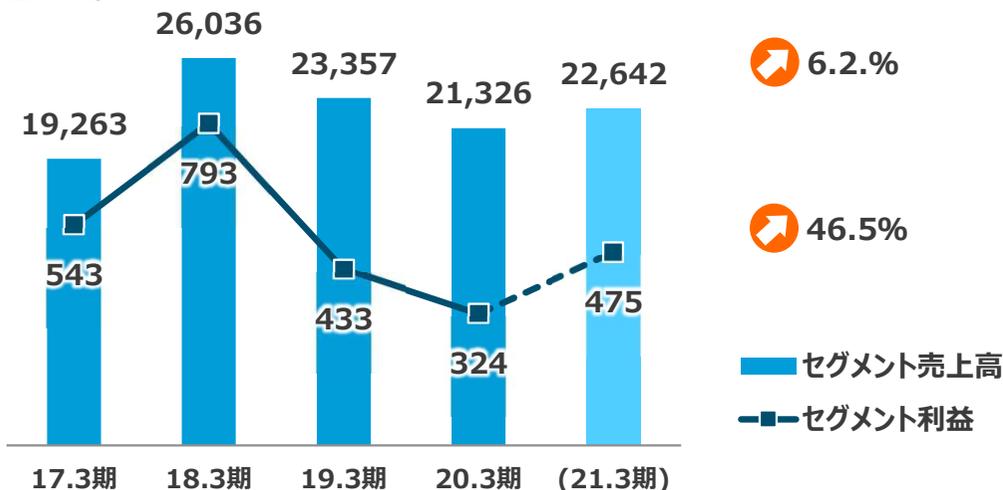
（百万円、％）

	2020.3期			2021.3期				
	実績	前期比	構成比	予想	前期比	構成比	上期	上期進捗率
売上高	23,825	△ 8.2	100.0	25,500	7.0	100.0	12,709	49.8
営業利益	547	△13.3	2.3	867	58.2	3.4	434	50.1
経常利益	533	△14.1	2.2	850	59.2	3.3	425	50.1
親会社株主に帰属する 当期純利益	333	△18.5	1.4	550	64.7	2.2	274	49.9

セグメント予想（変更なし）

◆ 販売事業

(百万円)



セグメント売上高 前期比 6.2%

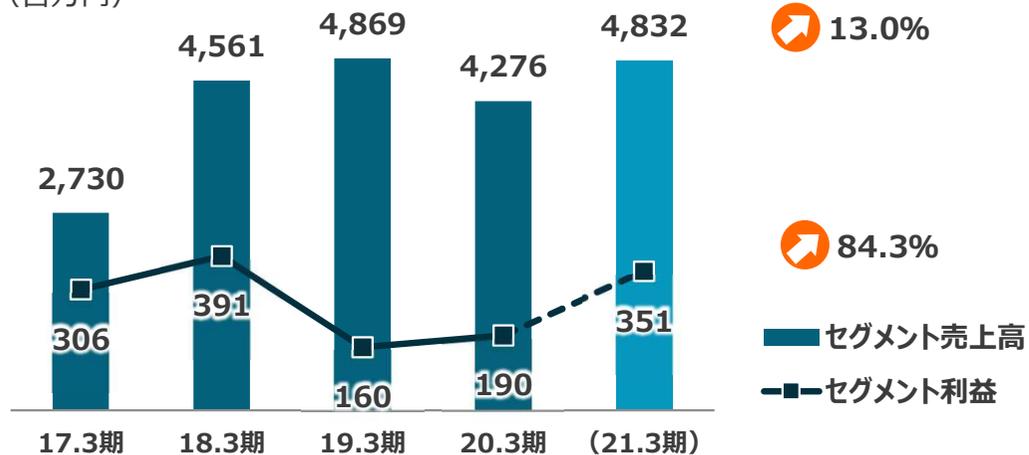
● 前期からのロジック投資堅調に加え、メモリ投資の回復を見込み、増収を予想。

セグメント利益 前期比 46.5%

● 売上増加及び業務効率化により利益増加を見込む。

◆ 受託製造事業

(百万円)



セグメント売上高 前期比 13.0%

● 主要顧客からの堅調な受注により増加傾向。

セグメント利益 前期比 84.3%

● 損益分岐点操業度の改善により収益改善を見込む。

(注) 売上高は連結調整前

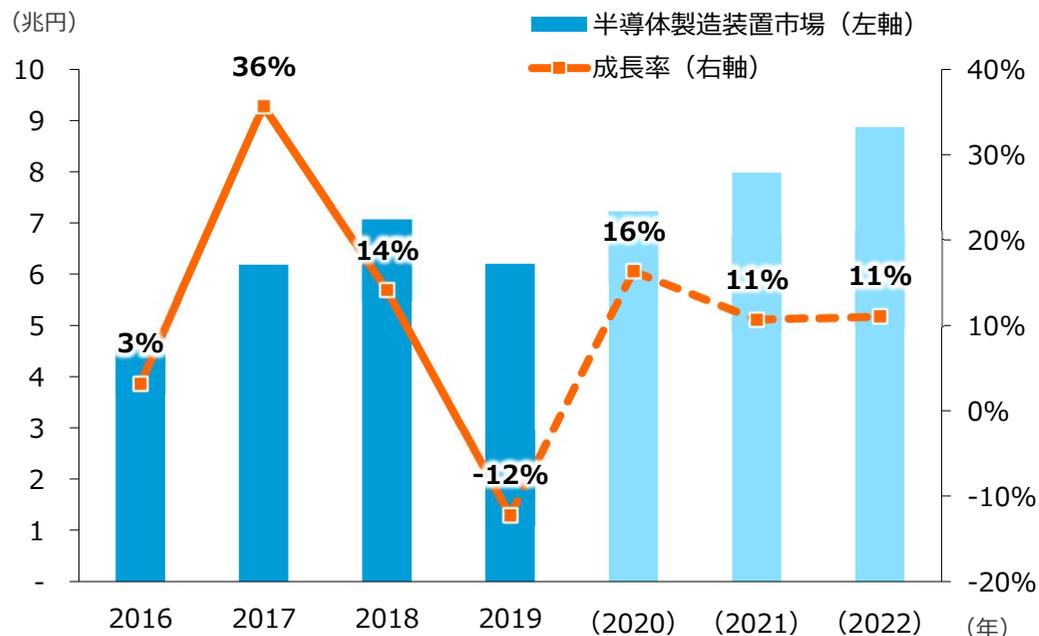
次なる成長に向けた事業戦略

創業60周年（2021年6月）を超えて 新量産技術を見据えた資金調達

代表取締役会長 権田 浩一

事業環境①：半導体製造装置の市場動向

半導体製造装置市場予測



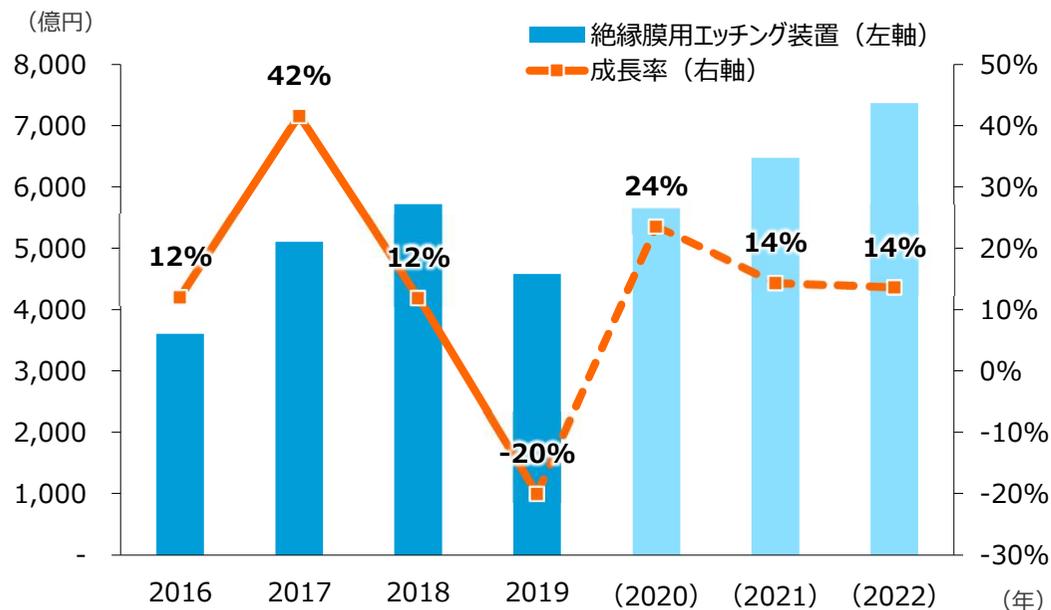
最新の半導体製造装置市場の予測値において、当面は10%を超える成長率が続く見込み

(グローバルネット社 2020年10月発行 世界半導体製造装置・試験/検査装置市場年間より)

- 2020年は、前半は新型コロナウイルス感染症による短期的な半導体需要の減速があったものの、テレワークやゲームなどの巣籠需要拡大、データ通信量増大によるデータセンター向け需要急増等により半導体投資の活発化が見込まれる。
- 2021年は、5G・AI・IoT・自動運転等の半導体新規需要の立ち上がり、新技術に対する量産投資開始等が見込まれる。
- 2022年に、NAND Flashメモリーにおいて128層から176層へ高積層化された製品の量産が開始される予定。

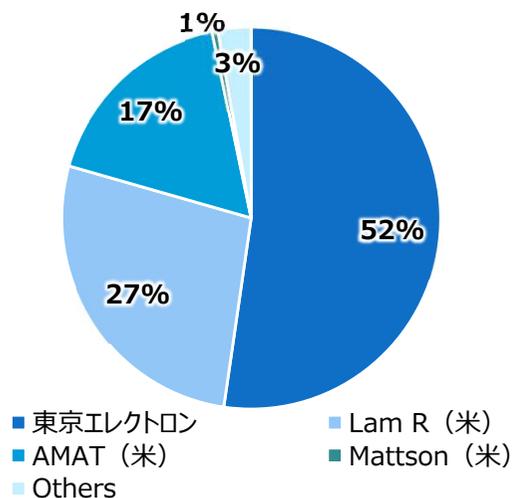
事業環境②：新工法の半導体製造装置市場への影響

絶縁膜用エッチング装置市場予測



「エッチング装置・中古改造装置市場」は15%前後の年率成長が見込まれ半導体製造装置市場全体を牽引する

絶縁膜用エッチング装置シェア (2019年)

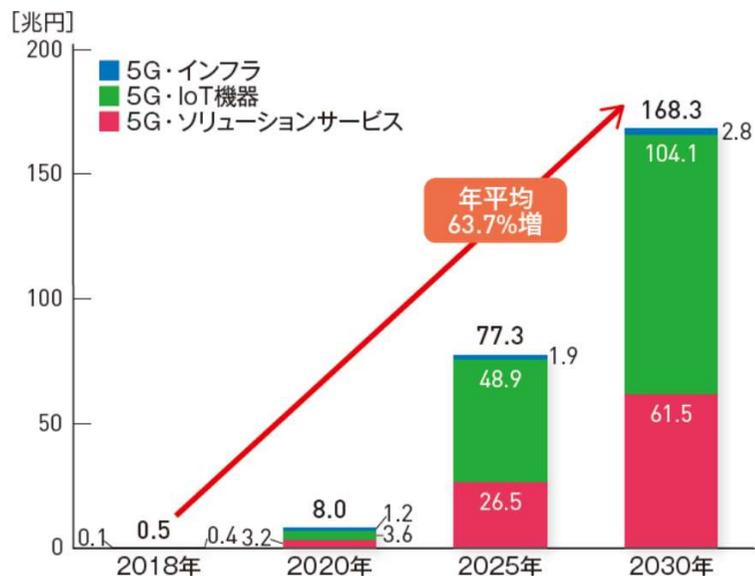


- 次世代NAND Flashメモリーにおいて、2022年に128層から176層へ高積層化された製品の量産が開始される予定。
- それに対応した新工法導入による絶縁膜用エッチング装置^(注)需要の拡大が見込まれる。

(注) シリコンウエハー上に作られた膜を削る装置には、絶縁膜（酸化膜）用エッチング装置、メタルエッチング装置などいくつかの種類があります。

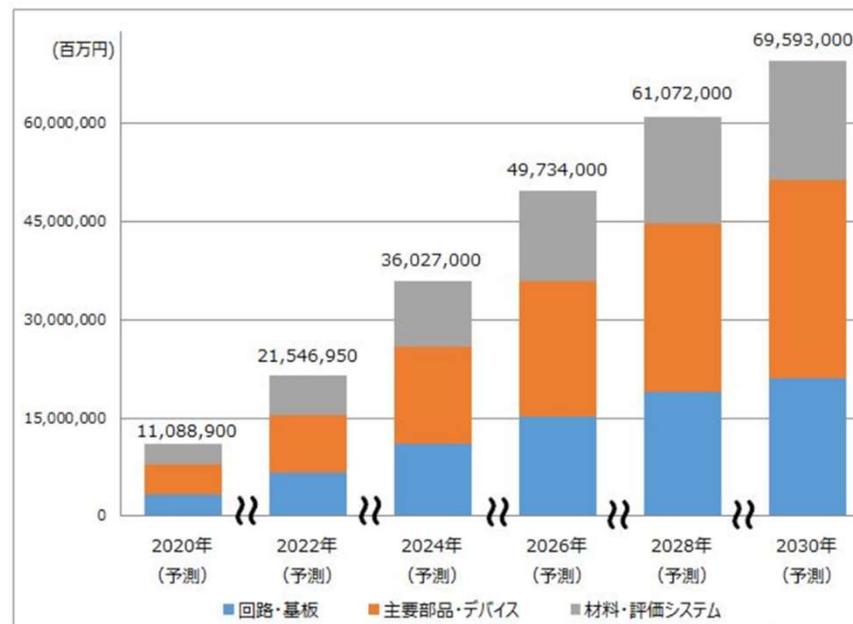
事業環境③： 5Gの世界的な普及拡大に向けて

5G市場の世界需要額見通し



(JEITA 2019年12月18日発表 5Gの世界需要額見通しより)

5G関連デバイス世界市場規模予測



矢野経済研究所調べ

注1.メーカー出荷金額ベース

注2.全て予測値

注3.回路・基板 (RF回路、基板等)、主要部品・デバイス (能動部品、液晶、アンテナ、受動部品、メモリ、その他デバイス)、材料・評価システム (材料、評価システム等) を対象とした。

(矢野経済研究所 2020年7月31日発表 5G関連デバイス世界市場規模予測より)

- 2020年は、5G通信が実用化されてまだ間もないが、今後データを瞬時に大量に処理するスマートフォンの高機能化、自動運転機能強化による車の更なる電装化などが見込まれる。
- メモリー半導体の大容量化/撮像半導体素子の搭載個数増加/高速処理が求められるロジック半導体など、中長期的な成長を可能にする技術的な半導体投資の更なる増加が見込まれる。

第1回新株予約権 (行使価額修正条項付新株予約権 (停止指定条項付))

		第1回新株予約権
資金調達総額 (※)		約14.4億円 (当初行使価額ベース)
新株予約権の個数		6,000個
潜在株式数/潜在希薄化率		潜在株式数600,000株/潜在希薄化率20.8% (直近の議決権株式数2,882,000株に対して)
権利行使可能期間		2年 (2020年12月8日~2022年12月7日)
行使価額	当初	2,405円 (発行決議日の直前取引日の東証終値)
	上限	なし
	下限	1,684円 (発行決議日の直前取引日の終値の70%)
	行使価額の修正	各行使請求日の直前取引日の終値の90%に相当する金額に修正 (ただし、下限行使価額は下回らない)
停止指定条項		当社は2020年12月9日から2022年6月7日までの期間中、割当先に対して行使ができない期間を指定することが可能
当社による任意取得		2週間以上の事前通知により、当社は残存する本新株予約権を発行価額と同額で取得することが可能

(※) 金額は、発行決議日の直前取引日の終値を用いた場合の当初行使価額で換算

(※) 詳細は、本日公表のプレスリリース「第三者割当による第1回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

既存株主の皆様の利益に十分に配慮しながら、さらなる成長に向けた資金を確保

1 過度な希薄化への配慮

- 発行後の当社株価動向にかかわらず、本新株予約権の行使による最大増加株式数が固定されていることから、株式価値の希薄化が限定（潜在株式数600,000株／潜在希薄化率20.8%）
- この点で、潜在株式数が増加する転換社債型新株予約権付社債（一般的なMSCB）とは異なる

2 株価への影響

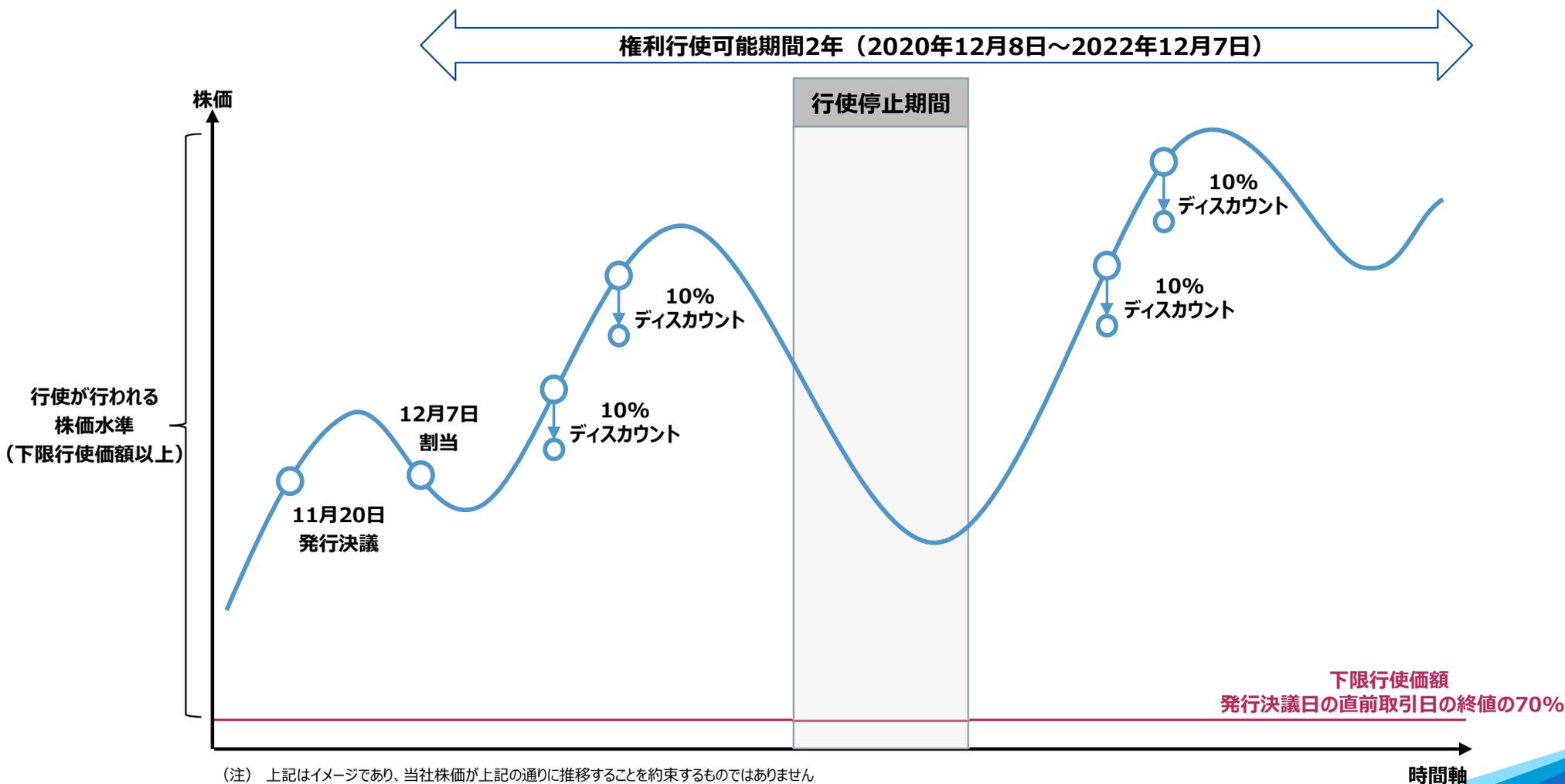
- 修正後の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正されることはなく、株価が下限行使価額を下回る等の株価低迷の局面において、さらなる株価低迷を招き得る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されるように配慮した設計
- 停止指定条項が付与されており、当社株価動向等を勘案して、当社が割当予定先による本新株予約権の行使を希望しない場合は、停止指定期間を指定することが可能

3 資本政策の柔軟性

- 資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により残存する本新株予約権の全部を取得することが可能

株価動向を見極めながら行使をコントロール

- 行使価額は行使請求の直前取引日の終値の90%に相当する金額に修正されます。
- 修正後の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正されることはありません。
- 今後の株価動向により、当初資金調達総額を調達できない場合があります。



受託製造事業を質及び量ともに深化させ、販売事業との相乗効果を図る

● 次なる半導体量産プロセス導入準備（受託製造事業の拡大）

- 内外エレクトロニクス仙台事業所でのエッチング装置需要増加に備えたCR（クリーンルーム）拡張
- 半導体製造装置の改造・メンテナンス・保守パーツ需要増加による設備増強
- 倉庫・ロジスティクスのグループ統合システム構築による工場スペースの確保と間接コストの大幅な低減

● 受託製造事業の利益貢献度上昇 = 収益性向上と変動性拡大に対する準備 = 財務安定性向上

- 過去3年の積極投資で可能となった「受託製造事業の拡大」の加速
- 受託製造事業の『改造・メンテナンス・保守パーツ』量的拡大による利益率向上と持続的成長
- 自己資本の充実による、成長分野への継続的な投資

● 受託製造事業から自社設計製造事業への変貌

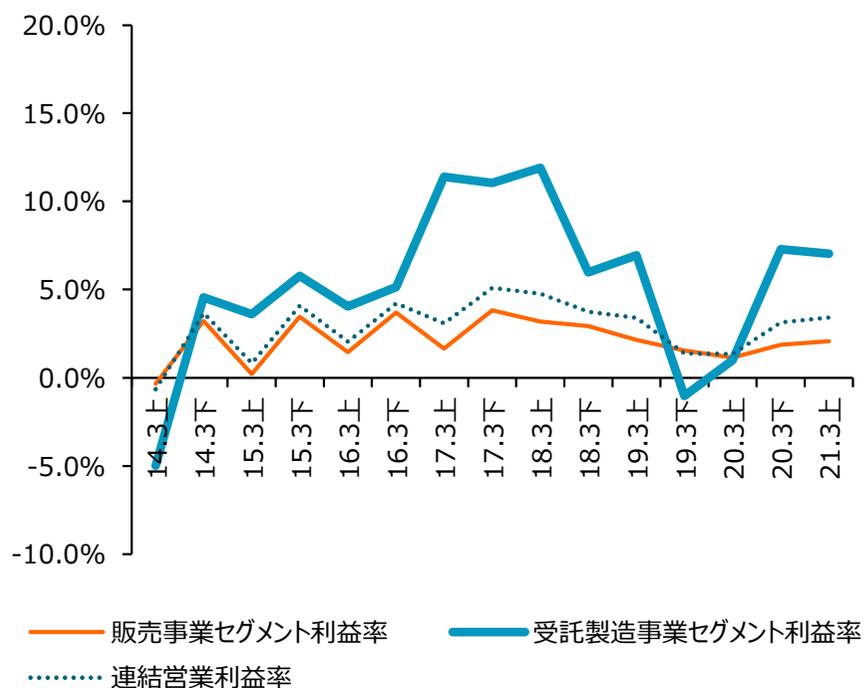
- 次世代半導体製造装置に対応する真空排気系ユニットの開発
- キーコンポーネントに関しては自社製造（加工）/その他パーツ、処理は約1,500社のリソースを活用
- 半導体製造装置の顧客拡大と他分野への市場拡大

資金用途

No	項目			金額
1	製造子会社 内外エレクトロニクス	宮城県	仙台工場の生産拡大のための設備投資資金及び倉庫・物流のグループ統合システム構築資金	5.0億円
2	製造子会社 内外エレクトロニクス	東北地区	新工場の新設並びに自社開発及び加工リソース確保のための設備投資資金	6.0億円
3	内外テック	東京都	製品自社開発のための開発リソース確保資金	3.4億円
合計				14.4億円

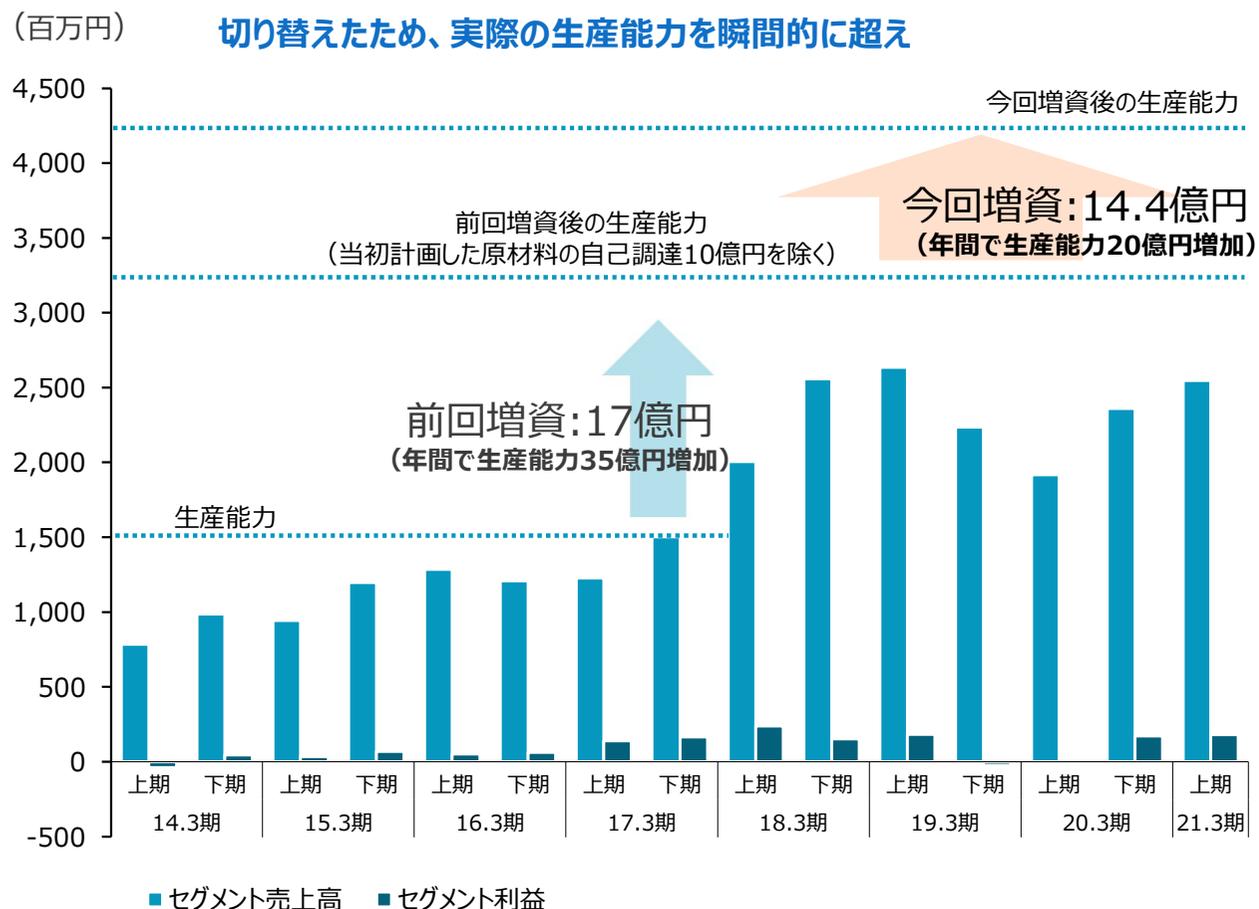
投資により年間生産能力20億円増

◆ 受託製造事業の高い収益性/変動性



◆ 生産能力を超過しつつある受託製造事業

当初計画した原材料の自己調達10億円程度を顧客支給に切り替えたため、実際の生産能力を瞬間的に超え



(参考資料)

会社概要

会社概要

所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、受託製造が2本柱
従業員数	連結 557名 (2020年9月末)
連結子会社	内外エレクトロニクス 株式会社 納宜伽機材 (上海) 商貿有限公司

内外テックの営業所・物流センター・開発センター ○
内外エレクトロニクスの事業所・サービスセンター(SC) ★

中国・上海



納宜伽機材 (上海)



半導体製造工程概要



5G対応のスマートフォンや基地局向け半導体の需要増を背景に
前工程装置の設備投資の再拡大が見込まれる。

内外テック
技術提案商社

+

内外エレクトロニクス
受託製造メーカー

＝ モノづくりができるメーカー商社

本日はありがとうございました。

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



『ものづくり』を支える

メカニカルソリューション

内外テック株式会社